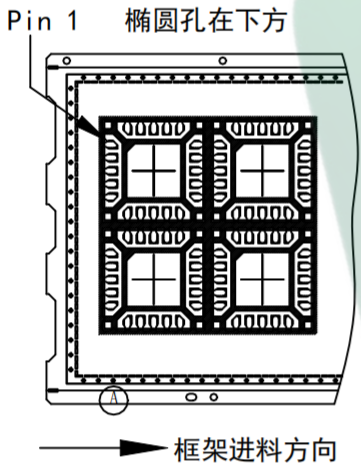
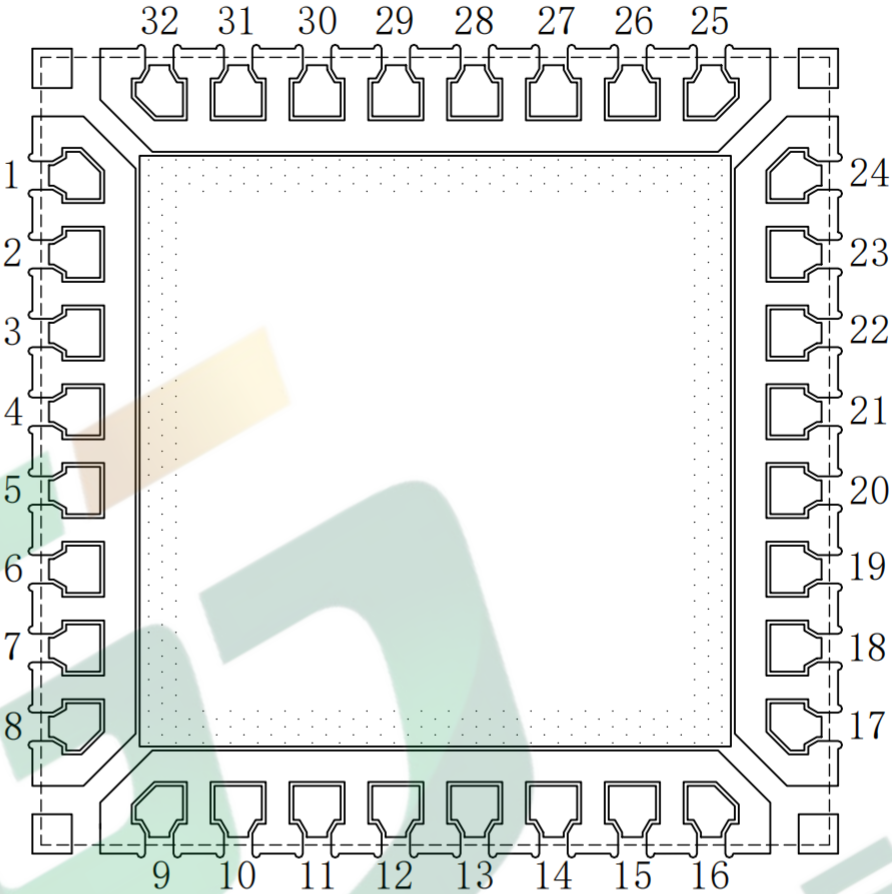




上海季丰电子科技有限公司

GIGA FORCE ELECTRONICS CO., Limited

| | |
|------------------------|------------------------|
| 压焊图名称 BD Name | |
| 图纸版本 Version No. | |
| 压焊图编号 BD No. | |
| 客户代码 Customer No. | |
| 产品型号 Device Name | |
| 封装形式 PKG Type | QFN32L (5X5X0.75-P0.5) |
| LF载体尺寸 Die Pad Size | 3750um*3750um |
| 焊线类型1 Wire Type | |
| 焊线类型2 Wire Type | |
| 焊线条数 Wire QTY | |
| 塑封料型号 Compound Type | |



备注

| | 芯片名称 Die Name | 芯片尺寸 Chip Size | 装片胶类型 Glue Type | 晶圆厚度 Chip thickness | 晶圆尺寸 Wafer Size | 切割道宽 Glue Type | 焊盘尺寸 Pad Size | 焊点间距 Pad Pitch | 铝垫厚度(um) Pad Thickness | PAD下有无电路 IF CUP PAD |
|-------|------------------|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|
| Die1: | | | | | | | | | | |
| Die2: | | | | | | | | | | |
| Die3: | | | | | | | | | | |

| 版本 Rev. | 变更历史 Change History | 日期 Date |
|------------|------------------------|------------|
| V01 | 新拟制 | |
| | | |
| | | |
| | | |

Mark规范

| | | | |
|------------|------------|-------------|---------------------------|
| 制图 Create: | 审核 Review: | 批准 Approve: | 客户确认 Customer Approve: |
| | | | |